

RENESAS

アニュアル・レポート 2011

2011年3月期

ルネサス エレクトロニクス株式会社

## プロフィール

### NECエレクトロニクス株式会社

2002年11月に、日本電気株式会社から分社・独立し、半導体企業として設立。世界中のお客様に、主に自動車・産業分野や民生分野向けの半導体製品を提供してきました。



### 株式会社ルネサス テクノロジ

2003年4月に、株式会社日立製作所と三菱電機株式会社の半導体部門(電力制御用半導体を除く)の事業統合によって設立。半導体を設計・製造するだけでなく、ソフトウェアを含めた、システムソリューションを提供する企業へとシフトしてきました。



2010年4月、NECエレクトロニクスとルネサス テクノロジの経営統合により、ルネサス エレクトロニクス株式会社へ

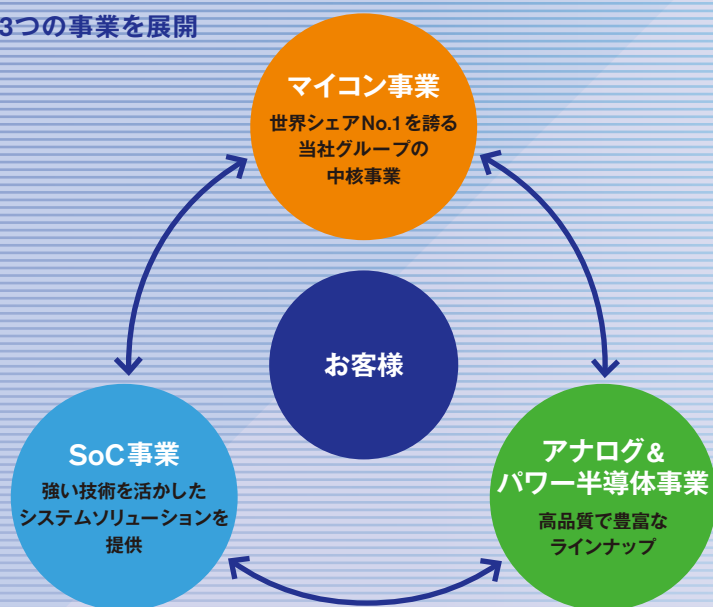
## 企業理念

ルネサス エレクトロニクスは、夢のある未来をつくる企業を目指し、叡智を結集した新技術により、地球と共生して人々が豊かに暮らせる社会の実現に貢献します。

## 企業ビジョン

私たちは、創造力を発揮し、絶え間ない技術革新により、世界中のお客様のニーズに誰よりも早く応えます。そして、信頼されるパートナーとして、持続的に成長する強いグローバル半導体企業を目指します。

## 3つの事業を展開



## 目次

01 財務ハイライト	16 東日本大震災からの復興	23 財務セクション
02 社長メッセージ	18 コーポレート・ガバナンス	30 グローバルネットワーク
03 事業概況	20 企業の社会的責任	32 株式情報
10 <b>マイコン事業</b>	22 取締役、監査役および執行役員	33 会社情報
12 <b>アナログ&amp;パワー半導体事業</b>		
14 <b>SoC事業</b>		

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略および業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因があります。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

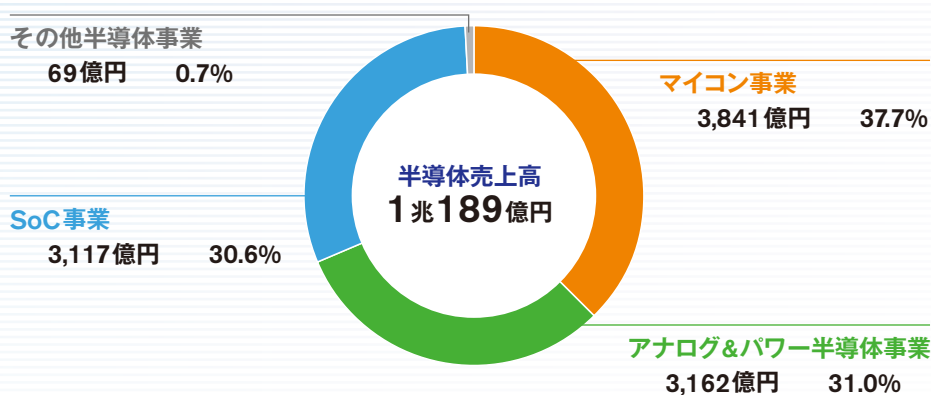
## 財務ハイライト

### 2011年3月期連結決算概要

売上高	1兆1,379億円
半導体売上高	1兆 189億円
その他売上高	1,190億円
営業損益	145億円
経常損益	10億円
当期純損益	△1,150億円
設備投資額	435億円
減価償却額等	1,151億円
研究開発費	2,026億円
総資産	1兆1,450億円
純資産	2,911億円
自己資本比率	24.8%
有利子負債	3,782億円

注:1. 億円未満を四捨五入して表示しています。  
2. 設備投資額は有形固定資産(生産設備)の発注額を表示しています。  
3. 減価償却費等は、キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費と長期前払費用償却額を合算した金額を表示しています。

### 半導体売上高の事業別状況



2011年3月期(当期)のアンニュアル・レポートをお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

当期の業績につきましては、合併初年度の経営目標であった通期の営業黒字を達成いたしました。構造対策の実行に伴う各種費用を計上したことに加え、東日本大震災の発生による特別損失を計上したことなどにより、当期純損益は1,150億円の赤字となりました。

また、今回の震災において、当社グループでは、合計8拠点で生産の停止を余儀なくされました。特に茨城県にある当社グループの主力工場の1つである那珂工場が大きな被害を受けましたが、グループ一丸となった復旧作業および社外関係者の方々の多大なるご支援により、当初の予想を上回るスピードで復旧を果たし、9月には震災前の状態に回復いたしました。

当社グループとしましては、引き続き震災からの復興とお客様への製品供給の最大化に向けて全力をあげて取り組むとともに、安定的な収益体質の実現に向けた事業構造対策の推進をより一層加速してまいりますので、引き続き変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



赤尾 泰

代表取締役社長

赤尾 泰

## 事業概況

### 2011年3月期(当期)業績報告

当期の連結売上高は、半導体市場全般の回復、特に新興国向けの需要の伸びなどにより、前期と比べ7.1%増加し11,379億円となりました。また、当社グループの主力事業である半導体売上高は、前期と比べ8.1%増加し10,189億円となりました。当社グループの主要な事業内容である「マイコン」、「アナログ&パワー半導体」、「SoC」という3つの製品群および3つの製品群に属さない「その他半導体」の各売上高は、次のとおりです。

マイコン事業の売上高は3,841億円となり、前期と比べ増収となりました。主に自動車、産業機器、民生用電子機器向けのマイクロコントローラの売上が増加したことによるものです。

アナログ&パワー半導体事業の売上高は3,162億円となり、前期と比べ増収となりました。パソコンおよび液晶テレビ向け表示ドライバICの売上が減少したものの、自動車向けやパソコン電源向けパワーMOSFETなどの売上が増加したことによるものです。

SoC事業の売上高は3,117億円となり、前期と比べ減収となりました。産業機器向け半導体や携帯電話端末向けカメラLSIなどの売上が増加したものの、パソコン周辺機器向け半導体や携帯電話端末向けベースバンドLSIなどの売上が減少したことによるものです。

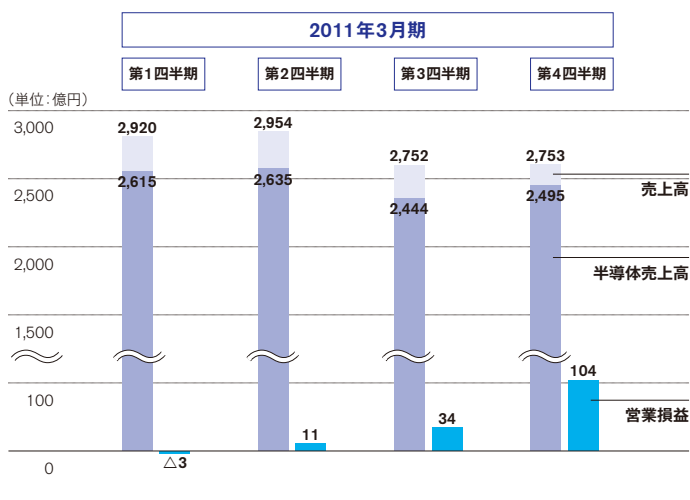
その他半導体事業の売上高は69億円となりました。

また、当社グループの連結売上高には、半導体売上高に加え、当社の販売子会社が行っている半導体以外の製品の販売事業、当社の設計および生産子会社が行っている半導体の受託開発、受託生産などのその他売上高が含まれています。当期におけるその他売上高は1,190億円となりました。

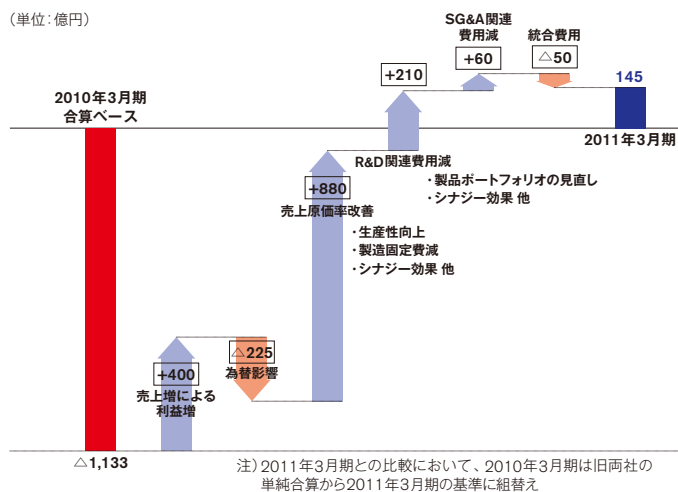
連結営業損益は145億円の利益となり、前期と比べ1,278億円の改善となりました。売上高が増加したことに加えて、設備投資の抑制などによる減価償却費の削減や、合併に伴う製品ポートフォリオの見直しなどによる研究開発費の効率化などの結果、合併初年度の経営目標であった当期の連結営業黒字化を達成しました。

連結当期純損益は1,150億円の損失となりました。当社グループの固定資産の減損損失を361億円、事業構造改善費用を306億円計上したことに加え、保険の適用による一部損失の補填はあるものの、東日本大震災の発生に伴う固定資産の修繕費や廃棄損など災害による損失を495億円計上した結果、特別損益が1,118億円の損失となったことなどによるものです。

#### 四半期決算概要



#### 2011年3月期通期営業損益の増減分析(対前期比)



売上高が増加したことに加えて、設備投資の抑制などによる減価償却費の削減や、合併に伴う製品ポートフォリオの見直しなどによる研究開発費の効率化などの結果、合併初年度の経営目標であった当期の連結営業黒字化を達成しました。

## ＞ 新たな事業方針の策定

当社グループは、このたび発生いたしました東日本大震災により大きな被害を受けましたが、震災からの復旧が完了し、改めて今後の当社グループの復興・あるべき姿を見直し致しました。そこで、今回の震災で顕在化したとも言える、エネルギー問題に関わる市場の変化、および2010年4月の統合以来、100日プロジェクトでも取り組んできた当社グループの課題を、新たな状況下にて再度検討した結果、当社グループの安定成長を確実にするための中期事業成長施策を骨子とする、新たな事業方針を策定しました。

### 震災影響と復興対策、そして中期成長への施策



## 中核事業の強化のための注力市場

注力市場のキーワードは海外市場、新興国、そしてスマート社会です。

電子機器や自動車市場において、新興国の急速な経済発展を背景に、普及価格帯製品の新規需要が増加することや、高機能化に伴う先進国での買い替えが促進されていくという、海外を中心とした市場成長の方向性が継続すると共に、新興国の急激な経済発展に伴う、世界的な電力消費量の増加が、限りあるエネルギー資源の効率

使用、いわゆるスマート社会への動きを加速させています。

今回の震災によるエネルギー供給の見通しの変化と、新興国での電力需要増を背景として、このスマート社会への変化は先進国、新興国が同期して起こってくる動きであり、新興国の経済発展に伴い、スマート社会における半導体への需要は、今後ますます増加し、数十年にわたり半導体需要を牽引していくと予測しています。

＞ 新興国の経済発展に伴い、スマート社会における半導体への需要は、今後ますます増加し、数十年にわたり半導体需要を牽引していくと予測しています。

キーワードは「海外市場」「新興国」「スマート社会」

成長ポテンシャルが大きい海外市場

- 新興国の急速な経済発展
- 電気機器・自動車などの高機能化および普及価格帯の需要増大

＞ 電力消費量の増加は“スマート社会”

(エネルギー資源の効率使用)を加速

＞ スマート社会の広がり先進国、新興国で同期、半導体市場を今後牽引

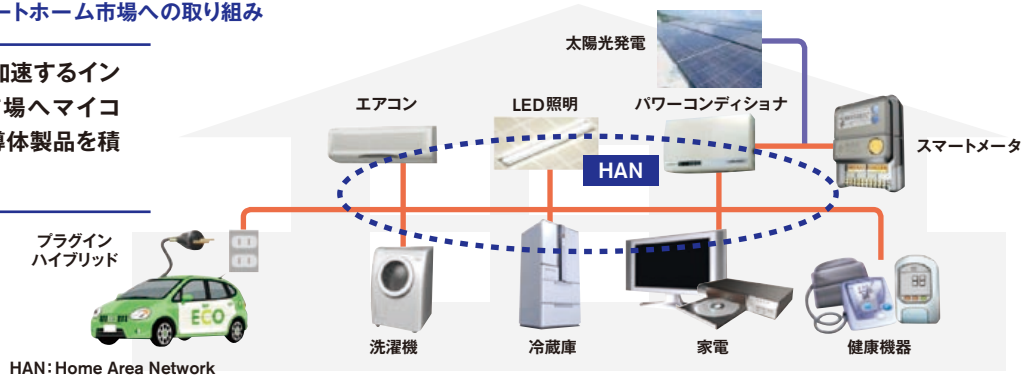


## ②スマートホーム

当社グループでは、世界シェア40%のインバータ家電向けマイコンを軸に、アナログ&パワー半導体製品とのリファレンスボードを作成し、お客様にキットソリューションを提供しています。家電機器をはじめ様々な機器に搭載されているモータやコンプレッサなどの回転数を細かく制御し、省電力化を実現するインバータ制御技術は電力の効率的使用のための鍵であり、その制御を担う当社グループのマイコン及びアナログ&パワー半導体製品にとって、インバータ化の進展は大きな売上成長の起爆剤とも言えます。長年の技術蓄積によって獲得したシェアを活かし、大きな成長を実現したいと考えています。

### スマートホーム市場への取り組み

省エネ化でグローバルに加速するインバータ家電、LED照明市場へマイコンとアナログ&パワー半導体製品を積極展開



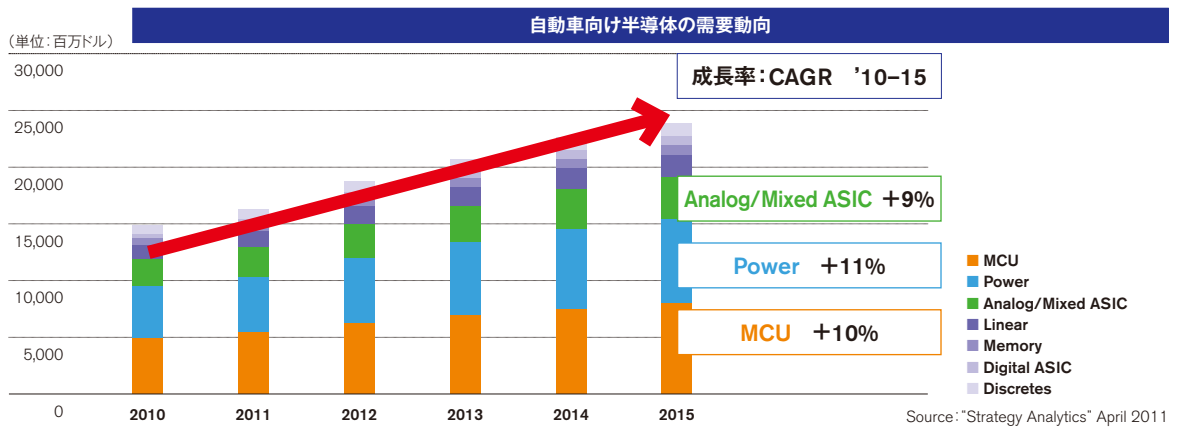
## ③スマートカー

新興国での普及拡大や、HEV・EV<sup>(※)</sup>比率の増大により、自動車向け半導体の需要は今後も継続して増加していくと予測しています。自動車向けマイコンで44%のシェアを有する当社グループは、その強みを軸に、アナログ&パワー半導体でもシェアを大きく伸ばしていきたいと考えています。当社グループの様々なマイコンラインナップにあわせて、アナログ&パワー半導体製品をデモボードで、お客様にキットソリューションの提案を行っています。また様々な自動車用途に合わせてサンプルソフトを提供することで、キットソリューションをご検討いただくお客様の開発期間の短縮を支援します。

(※)HEV: Hybrid Electric Vehicle (ハイブリッドカー)、EV: Electric Vehicle (電気自動車)

### スマートカー市場への取り組み

新興国での普及拡大や、HEV・EV比率の増大により、自動車向け半導体の需要は今後も増加の一途をたどる



## 海外／新興国市場強化

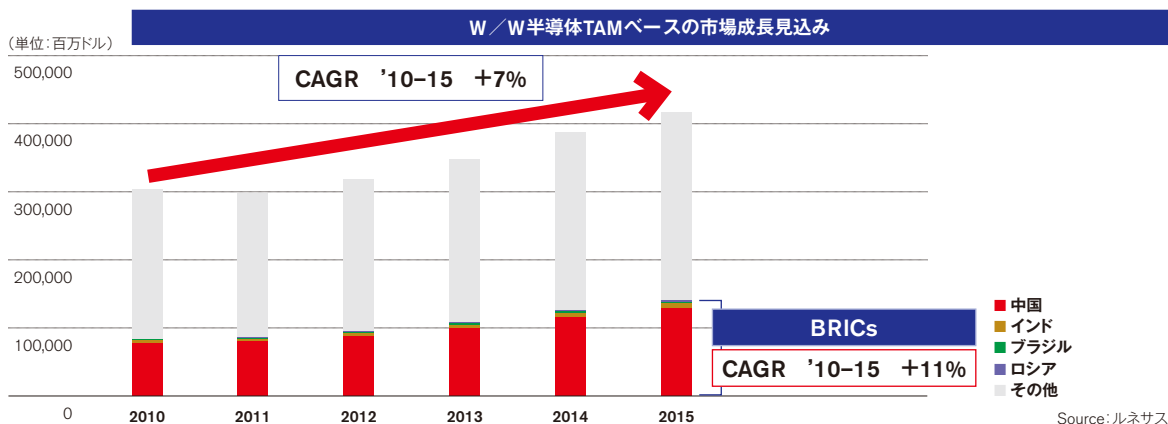
当社グループではこれまで、中国市場への取り組みを強化してきましたが、昨年度の取り組み強化の成果として、中国市場が伸長する中においても、その市場を上回る売上の拡大、シェアの大幅アップを実現することができました。2010年においては、中国マイコン市場において他社を大きく引き離す22%の市場シェアを獲得し、今後、確固たるポジションを構築するための基盤ができました。中国市場での拡大の要因といたしましては、トップクラスの要素技術・製品などを当社グループが持っているということも大きな拡大の要因ではありますが、やはり、現地のニーズに基づいて、現地での開発を促進する体制が回り始めていることが、当社グループの中国市場での躍進を支えている大きな理由だと考えています。今後も、現地のニーズを吸い上げ、現地での開発、生産に反映していくサイクルを恒常化していくことによって更なる強化を図っていきます。また、この現地に適合した事業のサイクルを、今後成長が見込まれる他の新興市場へ展開することにも着手し始めています。今後年率約40%の伸長が予想されるインド市場においては、すでにバンガロールに支店を開設し、現地ニーズの吸い上げや拡販サポートを行っています。また今後2桁成長が見込まれる、ブラジル市場においても、現地販売代理店と契約し、今後の現地ニーズの吸い上げのための足がかりとして事務所の開設を検討しています。加えて、こうした新興国を含む海外市場向けの拡販戦略を進める上で、マイコンとアナログ&パワー半導体の連携を推進する組織として、2011年4月にマーケティング本部を設立しました。従来、製品事業部で閉じてしまいがちなお客様のニーズの掘り出しやお客様への提案について、マイコンとアナログ&パワー半導体を横断的に対応し、これまで見過ごされてきた事業機会を確実に捉えていきます。また、マイコン、アナログ&パワー半導体製品を合わせた拡販ツールの提供や海外販売商社の教育なども行っており、拡販ポテンシャルに対して積極的に両事業をサポートしていきます。海外市場のニーズに合致したマイコンとアナログ&パワー半導体製品のベストソリューションの提供により、ビジネス獲得を目指します。

中国マイコン市場において他社を大きく引き離す22%の市場シェアを獲得し、今後、確固たるポジションを構築するための基盤ができました。

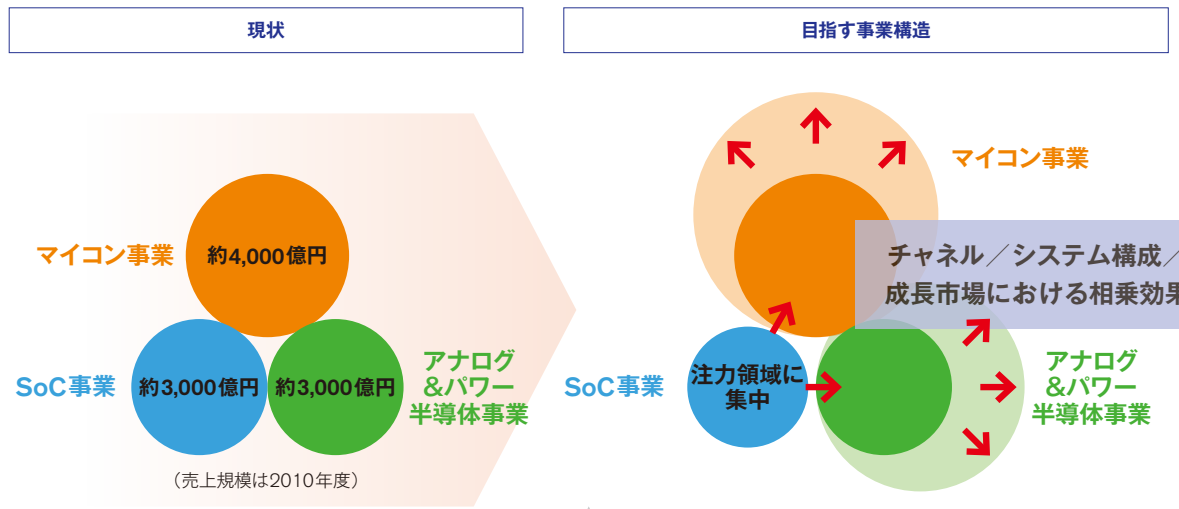
現地のニーズに基づいて、現地での開発を促進する体制が回り始めていることが、当社グループの中国市場での躍進を支えている大きな理由だと考えています。

## 新興国市場への取り組み

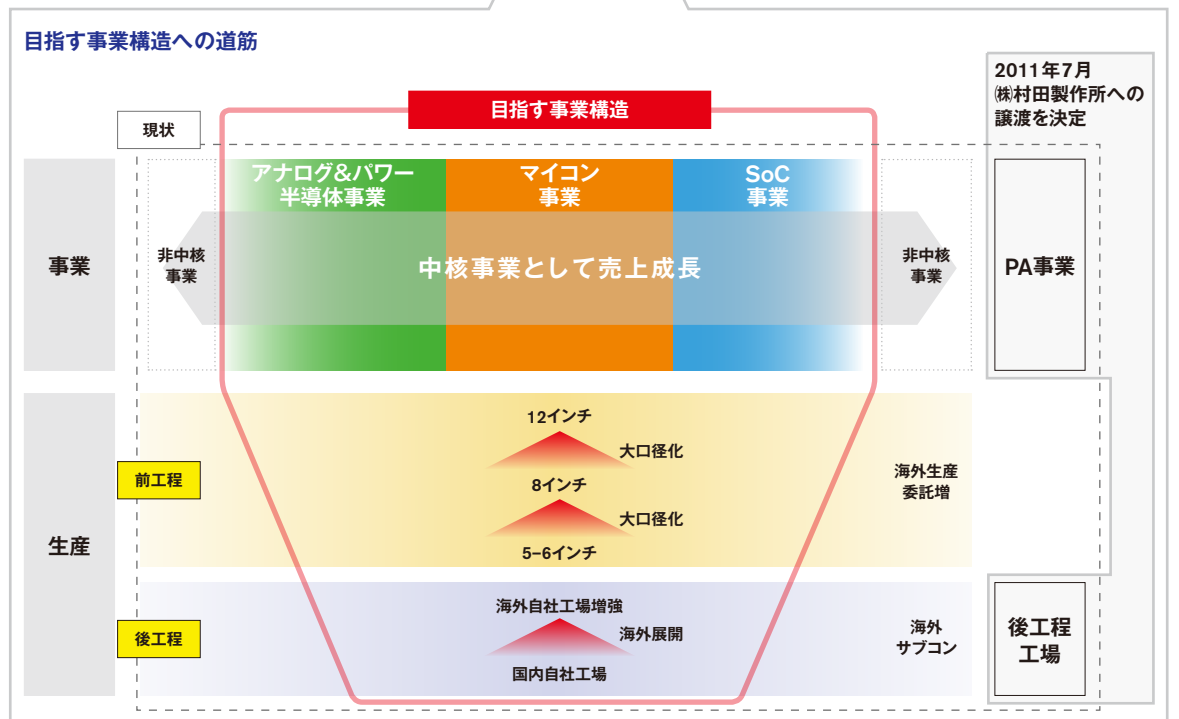
今後の半導体市場の成長は、中国を中心とする新興国市場が牽引



ルネサスの目指す事業構造



> 事業・生産を通しての構造改革により、安定成長と高い収益力を実現する企業として復興を果たします。



## 事業方針まとめ

### マイコン、アナログ&パワー半導体の両事業への注力を更に加速

- 世界シェアNo.1のマイコン事業はスマート社会、新興国向けに今後も拡大
- マイコンとアナログIC、パワーデバイスの相乗効果による更なる伸長、収益の柱に
- SoC事業は更に大胆な取捨選択を行い、社会・産業インフラ、クラウドコンピューティング関連市場向けへ集中

今回の事業方針の根幹は、マイコン、アナログ&パワー半導体事業への注力をさらに加速することです。今後の半導体需要を数十年のスパンに渡り大きく牽引するスマート社会・新興国市場は、当社グループのマイコン事業の強みをますます発揮できる市場です。加えて、その市場において、マイコンとの相乗効果の高いアナログ&パワー半導体をトップランクへ伸ばすことで大きな成長を目指します。一方、SoC事業、アナログ&パワー半導体事業のうち非中核事業については、譲渡・提携・その他の手段により縮小・撤退を行っていく計画です。2011年7月には、SoCのパワーアンプ事業について、モジュールビジネスの核となってその競争力を発揮すべく株式会社村田製作所への事業譲渡を決定しました。

また、事業ポートフォリオの見直しと同期して、それを支える事業構造の変革を加速します。固定費の多くを占める生産は、前工程において大口径化を進めると共に、マルチファブ構想の一環でもある海外生産委託へシフトしていきます。後工程においては、国内は技術育成のマザーファクトリーとして強化する一方、福岡工場、ルネサス東日本セミコンダクタの東京工場など、一連の発表にあるように売却・閉鎖を含む再編を加速します。事業・生産を通じた構造改革により、安定成長と高い収益力を実現する企業として復興を果たします。

これらの事業ポートフォリオの見直しと構造改革により、2012年度は営業損益・当期純損益とも黒字転換を果たし、中期的には営業利益率10%を超えて安定した収益を上げる企業となります。

### 目標とする財務指標

対売上高比率	2010年度		中期的目標
営業利益(OP)	1%	事業構造の変革 ■ 中核事業の強化 ■ 非中核事業の撤退加速 ■ 生産再編	10%以上
売上総利益(GP)	34%		約40%
研究開発費(R&D)	18%		約16%
販売費および一般管理費(SG&A)	15%		約14%
		2012年度通期	
		■ 営業損益 黒字化	
		■ 当期純損益 黒字化	

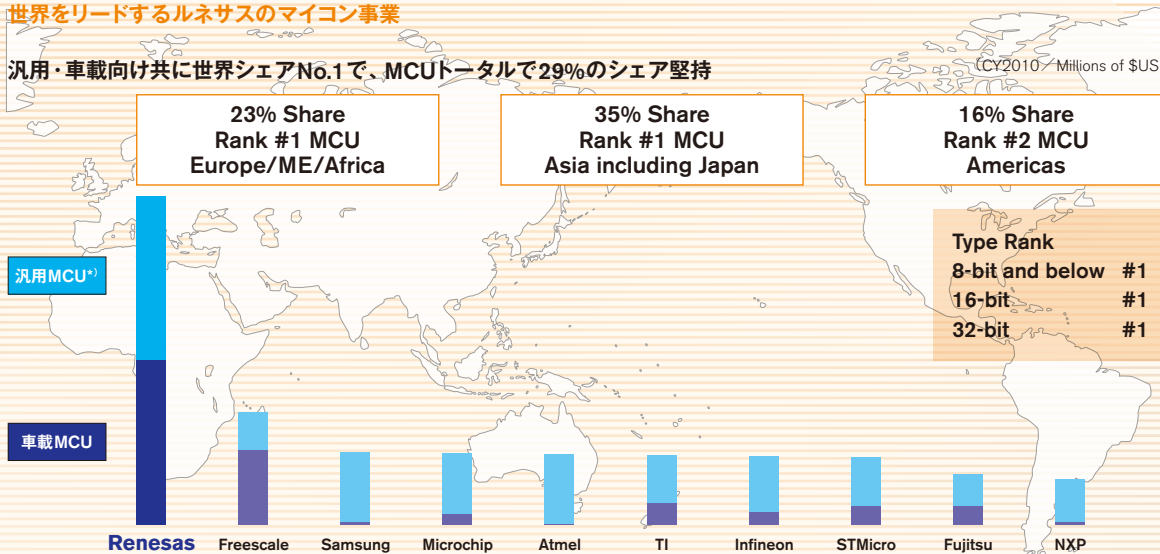


# マイコン事業

マイコン事業は、汎用品、車載向けともに世界No.1シェアを堅持しており、競合メーカーとの比較においてもバランスの良い売り上げ比率になっています。

## 世界をリードするルネサスのマイコン事業

汎用・車載向け共に世界シェアNo.1で、MCUトータルで29%のシェア堅持



\*) 汎用MCU: 車載向けMCU売上げを除くその他アプリケーション向けMCU市場

Source: Gartner, "Market Share: Semiconductor Applications, Worldwide, 2010," 30 March 2011, "Market Share Semiconductor Devices Worldwide 2010," 30 March 2011, Chart created by Renesas Technology based on Gartner data. Renesas Technology's MCU revenues in the 1st quarter (Jan.-Mar.) of 2010 has been combined in Renesas Electronics MCU revenues in 2010.

(注)ここに述べられたガートナーのレポート(以下「ガートナーのレポート」)は、ガートナーのシンジケート購読サービスの一部として顧客向けに発行されたデータ、リサーチ・オピニオンもしくは視点を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーの各レポートは、レポート発行時点における見解であり、この企業レポート発行時点のものではありません。またガートナーのレポートで述べられた意見は、事前の予告なしに変更されることがあります。

## > マイコン事業の強み

### 高品質 〈安全性の向上〉

#### ゼロディフェクトを目指して

設計から製造までの組織横断的な不良率改善活動のノウハウの蓄積により、250万個に1個の不良しか出ないという、ほぼゼロディフェクトに近い不良率を実現しています。

### 低電力 〈エコ推進をサポート〉

#### 世界トップクラスのローパワー

CPUコアとプロセスを最適化することで、世界トップクラスの低消費電力を実現しています。スマート社会への市場変化の中で、低消費電力への要求は高まっており、当社グループの低消費電力マイコンは高い評価を得ています。

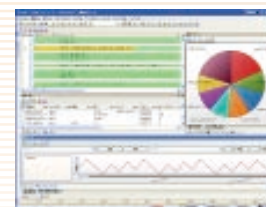
### 統合ツール推進 〈最適な開発環境の提供〉

#### 統合したGUI<sup>(\*)</sup>が同一操作で全てをサポート

お客様の機器のバージョンに合った最適なCPUコアの提供を行いつつ、開発環境においてもコアの違いを感じさせない統合ツールの提供を2011年開始しました。

この統合ツールの提供により、当社グループのローエンドからハイエンドまで広範囲にカバーできるCPUコアを、お客様の開発環境を変えることなく提供でき、お客様がスムーズに、製品のバージョン展開することが可能になります。

\* GUI=Graphical User Interface



**CubeSuite+**

\*) CubeSuite+ 統合開発環境

## サポート体制 〈トップレベルのホスピタリティ提供〉

### マイコンを拡販する上で重要なサポート体制

当社グループはワールドワイドで700社を超えるパートナーとアライアンスしており、当社グループ製品と連携する多くのパートナー各社の製品、サービスなど、幅広いソリューションをお客様に提供しています。



当社グループ製品を使うときにはワールドワイドで様々なサポートが受けられる環境が整っています。

## グローバルネットワーク

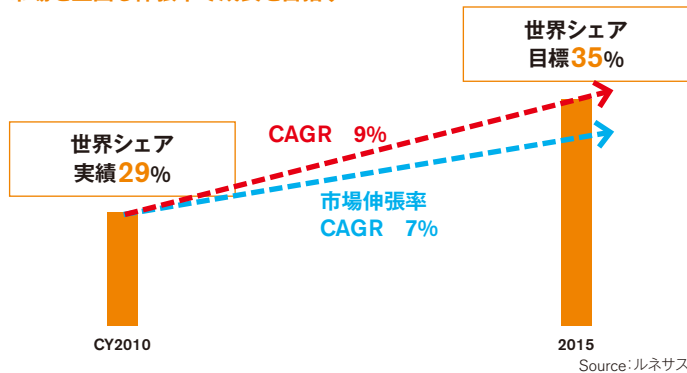
### お客様の地元でサポートできる体制をワールドワイドに構築

特に、自動車分野については、ヘッドクォーターである日本はもちろん、ヨーロッパ、北米、中国に拠点を置き、アカウントマネージメントによるグローバルな販売体制や、マーケティングや技術サポートにおけるグローバル体制を構築しています。

## 〉 今後の取り組み

マイコン事業については、これまで説明した世界トップクラスの強みを生かし、スマート社会に代表される成長分野での拡大、また中国を含む新興国市場での不動のポジション確立を目指し、2015年には市場成長を上回る年率9%成長を実現し、マーケットシェア35%を目指します。

### 市場を上回る伸張率で成長を目指す



## トピックス

### 中国事業～現地のニーズを捉えた事業推進～

当社グループでは、激変する中国市場において、市場環境の変化に即応し、中国市場に適した製品拡充体制を構築するため、現地における事業体制を強化いたしました。

現地の環境、顧客ニーズを迅速に捉え、タイムリーに設計開発や製造の意志決定“Just in Function”、“Just in Quality”を実現し、2012年までに中国向けにマイコン新製品を1,000製品開発することで、当社グループは中国市場におけるマイコン製品の売上を拡大していきます。



# アナログ&パワー半導体事業

パワーデバイス事業は、世界シェア第1位の低圧MOSFETをはじめ、低圧から高圧までのフルラインナップにより、機器の効率化に広く貢献しています。

アナログIC事業は、車載・コンシューマ・PC向けを中心に、アナログIC市場の約6割を占めるアナログASIC/ASSP製品を展開しています。

## ＞ 当社グループのパワーデバイス事業

### 低圧パワーデバイス

当社グループの低圧MOSFETの強みは、小さなオン抵抗、速いスイッチング特性、高密度実装の技術にあります。電池・電源・車載向けなどで電力消費の効率化、機器の小型化に貢献し、第1位のシェアを堅持し、売上を伸ばしていきます。

電池用MOSFET	PC・サーバ電源用SVRソリューション	車載用パワーデバイス
世界最小チップで豊富な実績	省エネ、省スペース、簡単評価	車載用MOSFET
<p>携帯電話電池用MOSFET</p> <p>電極 (実装側) 1.65×1.65mm 基板実装状態</p>	<p>MCU内蔵1chip高性能コントローラ + 高効率パワーデバイス Dr.MOS</p> <p>マイコン HBS + アナログ制御回路 (5×5mm) → ドライバ+MOSFETx2 in 1 package (6×6mm) → 最適電力制御 CPU</p> <p>SVR: Scalable Voltage Regulator</p>	<p>小型パッケージから大電流ベアダイまで幅広い要求に対応</p> <p>75A 6×5mm    180A    180A~ベアダイ</p>
		IPD (Intelligent Power Device)
		保護回路機能付きスイッチ
		制御IC    出力MOSFET

### 高圧パワーデバイス

高圧デバイスでは、電力消費効率化の鍵を握るインバータ制御において差異化が可能なこれら微細トレンチ技術、薄ウエハ加工技術、高密度実装で高効率、小型化を実現し、シェアの伸長を図っていきます。具体的には、600V超の耐压製品を大幅投入すると共に、従来手がけていなかった900V以上の市場向けにも製品展開を行い、市場シェアを高めていきます。

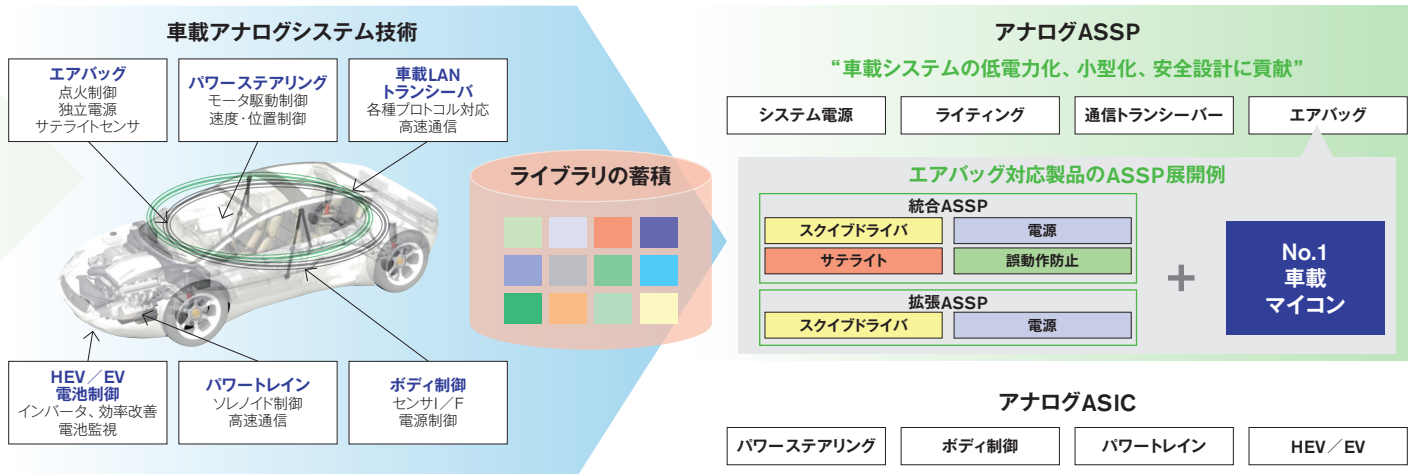
高圧MOSFET (200V以上)	IGBT	SiCダイオード
深いトレンチ (50ミクロン) 構造により低オン抵抗、高速スイッチングを実現	薄いウエハ (70ミクロン@8インチ) により低飽和電圧を実現	新材料SiC採用で複合化IGBTとワンパッケージに搭載しインバータ回路の高効率化を実現
<p>50ミクロン</p>		<p>SiC ダイオード</p> <p>NC Vcc Com GND</p>

## ＞ 当社グループのアナログIC事業

### 車載用アナログIC

車載システムはセンサ入力、メカ制御を要するためアナログICがキーとなっており、小型化、高密度実装に向け、アナログICを核に周辺との一体化が進展しています。

当社グループでは、豊富な車載アナログシステム技術をライブラリとして蓄積することで、車載システムの低電力化、小型化、安全設計に貢献するアナログASSPを展開します。



### バッテリー制御ソリューション

バッテリーマネジメントの領域ではマイコンとアナログICをワンパッケージ化することによりバッテリーの長時間使用が可能となります。

現在はクラウド端末などモバイル機器のバッテリー向けが主力ですが、将来的にはEV・HEVのバッテリー向けの展開も見据え取り組んでいます。

## ＞ 今後の取り組み

アナログ&パワー半導体事業については、当社グループの持つ技術優位性とマイコンとのシナジー効果を最大限に活かすことで、世界のトップランク入りを果たします。

### 市場シェアの目標

#### パワーデバイス事業

##### Power transistor & Thyristor

	CY2010	CY2015
1位	11%	
2位	9.2%	
3位	8.4%	
⋮		
5位	ルネサス 7.4%	10%以上

#### アナログIC事業

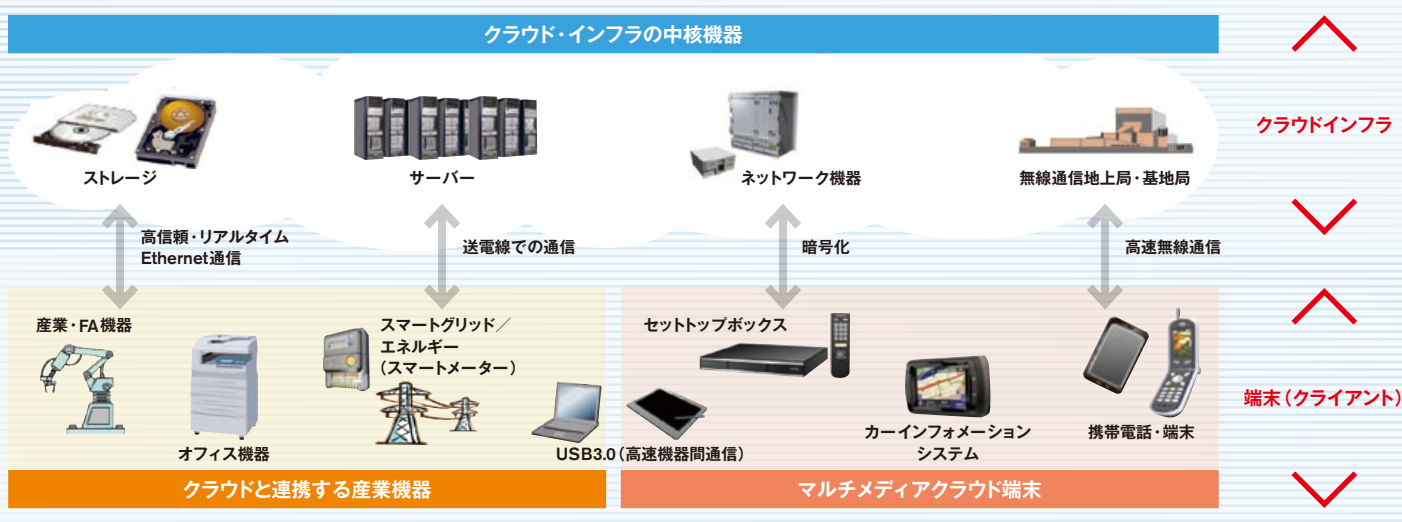
##### Analog application specific IC

	CY2010	CY2015
1位	10.9%	
2位	9.0%	
3位	6.7%	
⋮		
6位	ルネサス 3.9%	5%以上

Source: IHS iSuppli社CY10実績

# SoC事業

SoC事業は、製品ライフサイクルが短いコンシューマ向けは絞り込み、産業・社会インフラ領域へ集中します。スマート社会を支える基盤産業であるクラウド・インフラの中核機器およびクラウドと連携する産業機器や、クラウドとの接続技術を強化し、システムソリューションが活きるマルチメディアクラウド端末向けにSoC事業のリソースを集中します。



## ＞ 産業・社会インフラ領域へ集中

### クラウド・インフラの中核機器・産業機器向けSoC事業

長年にわたって安定した需要が見込めるインフラの中核機器・産業機器向けに、当社グループの持つ高性能・高信頼性・長期安定供給力を最大限活かし、SoC事業の安定を図ります。

具体的には、エネルギー分野やFA・制御分野、無線通信やネットワーク分野に対して、低消費電力技術や実績に裏付けられた高品質・高信頼性や、長期的かつ安定的な生産体制をベースに、国内外のきめ細かい販売・技術網とカスタムLSIの設計プラットフォーム、そして産業・通信用の豊富なIP(設計部品)により、高性能、高信頼、製品差別化というインフラ・産業機器向けのニーズにこたえることにより、事業の安定に寄与していきます。

### クラウド端末としてのセットトップボックス

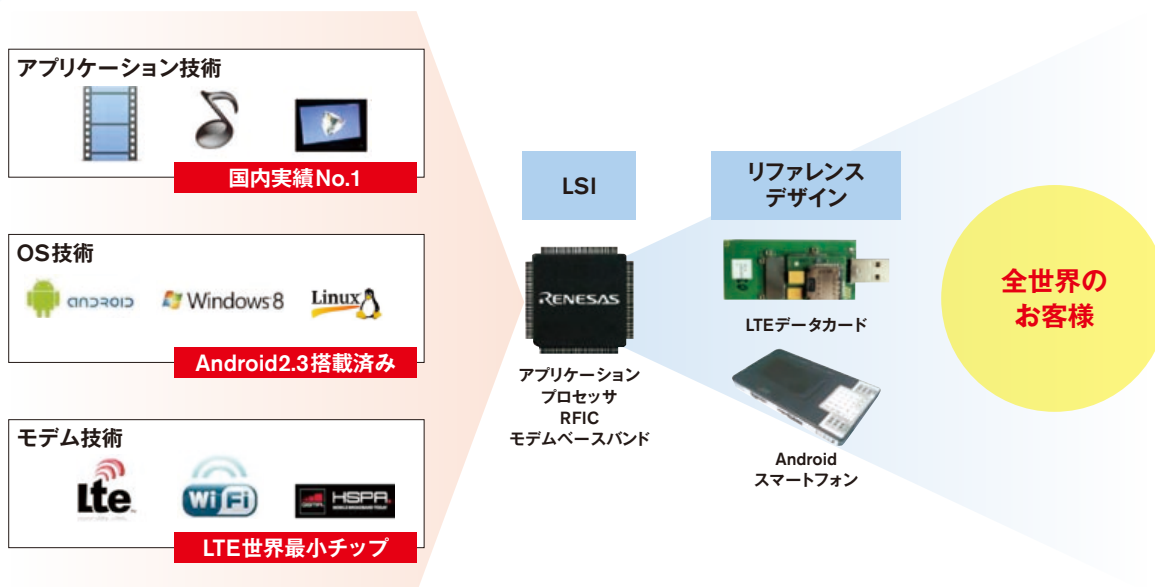
クラウド端末の代表的なアプリケーションとして、セットトップボックスに注力します。インターネット上でやり取りされる動画のうち、課金対象となる動画のサービスも今後大きく成長していくことが見込まれています。このサービスに必要なセットトップボックス向けSoC事業は、オペレータが指定する暗号化技術をLSIに搭載するなど、端末メーカーへのLSIの提供を行うだけでなく、通信事業者との連携が必要になるビジネスです。このようにクラウド社会のインフラとなるLSIを広く端末メーカーに提供していくなど、一般的な民生機器にLSIを提供することとは異なる領域に集中します。

## ＞ ルネサス モバイルの戦略

クラウド端末向けに注力するのはルネサス モバイル株式会社(以下、ルネサス モバイル)です。クラウド端末向けは、今後も製品ライフサイクルが速く、需要変動が大きい市場であると認識しており、ファブレス企業であるルネサス モバイルの強み・特性を活かし売上を伸ばしていきます。

ルネサス モバイルは、世界で最も高度のアプリケーション機能が求められる日本において実績No.1のアプリケーション技術資産に加え、ノキア・コーポレーション(以下、ノキア)から得た世界標準のモデム技術をベースにしたLTE<sup>(※1)</sup>最小チップを組み合わせたモバイルプラットフォームソリューションに世界標準OSのAndroidなどを搭載し、世界のお客様から評価いただいています。

また過去の経験から、ハードウェア、OS、アプリ以上に重要と考えているのが、通信業界における長いバリューチェーンの中でのパートナーシップ・コネクションです。モバイルプラットフォームに先端技術を搭載し、モバイル/ネットワーク機器に搭載いただくためには、ネットワークオペレータ、ネットワークベンダーの関係各所と長年にわたる密接なパートナーシップの構築が必須となります。このような幅広いパートナーシップの実績を持つのはルネサス モバイルを含む数社に限定されており、ルネサス モバイル約1,800名の社員中8割弱を占める海外の従業員の多くがこうした活動に従事しています。すでにルネサス モバイルでは、2011年12月から出荷の始まるオーダー受注案件を含む、海外2社、国内2社にてモバイルプラットフォームのデザインインを獲得しており、成長への一歩を踏み出しています。



## トピックス

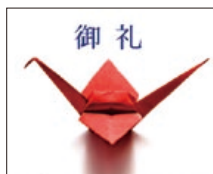
### ノキアワイヤレスモデム技術の買収

当社は、2010年7月、ノキアとHSPA+<sup>(※2)</sup>やLTE以降の通信規格に向けた半導体ソリューションとモデム技術の開発について戦略的提携契約を結び、この事業提携の一環として、ノキアのワイヤレスモデム事業を買収する契約を締結しました。また、本事業買収にあたり、当社は、当社が100%出資するルネサス モバイルを設立しました。ルネサス モバイルは、当社グループのモバイルマルチメディア事業(買収したノキアのワイヤレスモデム事業を含む。)を吸収分割することにより、2010年12月より運営を開始しました。

ルネサス モバイルは、携帯電話やカーナビゲーション、ネットブックなど多様な携帯機器から成るコンバージェンス市場に、当社グループの世界No.1シェアのマイコン事業で培った顧客関係を活用して、ノキアのワイヤレスモデム技術と、市場実績が豊富な当社グループのアプリケーションプロセッサなどを組み合わせたモバイルプラットフォームを提供していきます。

(※1) Long Term Evolution: 携帯電話の高速データ通信規格の一つであり、3.9Gと呼ばれる。

(※2) High Speed Packet Access Plus: 第3世代(3G)携帯電話のうち「W-CDMA」のデータ転送を高速化した規格。



東日本大震災の発生により、当社グループは那珂工場をはじめとして大きな被害を受けました。当社グループ一丸となった復旧作業および社外関係者の方々からの多大なるご支援により、被災したすべての工場において復旧を果たすことができました。この場をお借りして、復旧にご尽力、ご支援いただきましたすべての方々に、心より厚く御礼申し上げます。

### 東日本大震災における当社グループの影響

今回の震災において、当社グループでは、半導体前工程工場5拠点、半導体後工程工場3拠点で生産の停止を余儀なくされました。特に、当社グループ全体の約15%を生産する主要工場である那珂工場（茨城県ひたちなか市）は大きな被害を受けましたが、日夜の懸命な復旧作業により、2011年6月に一部生産を再開することができました。さらに、被災前に那珂工場で生産していた製品については、お客様への製品供給の充足を最優先に、那珂工場の生産再開による製品供給と、代替生産による製品供給を並行して進めた結果、震災当初の見通しからは大幅な前倒しを果たし、同年9月中旬には、同工場での生産再開分と当社グループの別工場やファウンドリにおける代替生産品をあわせて被災前の那珂工場供給レベルに相当する製品の供給が可能となりました。

**震災後  
(3.21撮影)**

**早期復旧**

**震災の影響を受けた当社グループの生産拠点**

- 半導体前工程
- 半導体後工程

- (株)ルネサス北日本セミコンダクタ 津軽工場 (半導体前工程)
- (株)ルネサスハイコンポーネンツ (半導体後工程)
- ルネサス山形セミコンダクタ(株) 鶴岡工場 (半導体前工程)
- (株)ルネサス北日本セミコンダクタ 米沢工場 (半導体後工程)
- ルネサス エレクトロニクス(株) 那珂工場 (半導体前工程)
- (株)ルネサス東日本セミコンダクタ 東京デバイス本部 (半導体後工程)
- ルネサス エレクトロニクス(株) 高崎工場 (半導体前工程)
- ルネサス エレクトロニクス(株) 甲府工場 (半導体前工程)

### 東日本大震災による当社グループの特別損失計上額

今回の震災による特別損失の詳細については、以下の表のとおり、損失の7割近くを占める原状回復のための固定資産の修繕費を中心に、資産の廃棄損や操業休止の固定費などが発生しました。これらの結果、震災による損失見積額は655億円となったものの、保険による補填が160億円見込まれることから、2011年3月期において震災による特別損失を495億円計上しました。

加えて、2012年3月期第1四半期においても、操業休止の固定費を中心に、119億円の特別損失を計上しています。

(2011年3月期)

内訳	金額
固定資産の修繕費(原状回復費用)	431億円
たな卸資産廃棄損	73億円
固定資産の廃棄損	62億円
操業休止の固定費(不稼働損失)	59億円
リース解約損失、その他	30億円
<b>震災による損失計</b>	<b>655億円</b>
未収受取保険金	△160億円
<b>震災による特別損失計</b>	<b>495億円</b>

## ルネサスのBCP（事業継続計画）

当社グループでは、今回の東日本大震災において、当社グループの複数の工場が被災し多くのお客様にご迷惑をおかけしました。この震災で学んだことをいかし、従来のルネサスのBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）をより強化します。そして、お客様へ安定供給を継続的に行えるよう、耐震強化や代替生産の拡充、またリスク情報のお客様との共有などを強化推進します。

具体的には、まずは、今後、地震で被災しても、1ヵ月で生産復旧を行える強靱な工場を構築します。耐震を強化し、最低でも東日本大震災と同レベルの震災には耐える工場にします。また、実際に復旧に時間がかかった点を洗い出し、そのポイントを重点的に改善します。さらに、この震災で学び、改善したことを、被災工場のみならず、当社グループ全生産工場への展開を図り、グループ全体の強化を図ります。

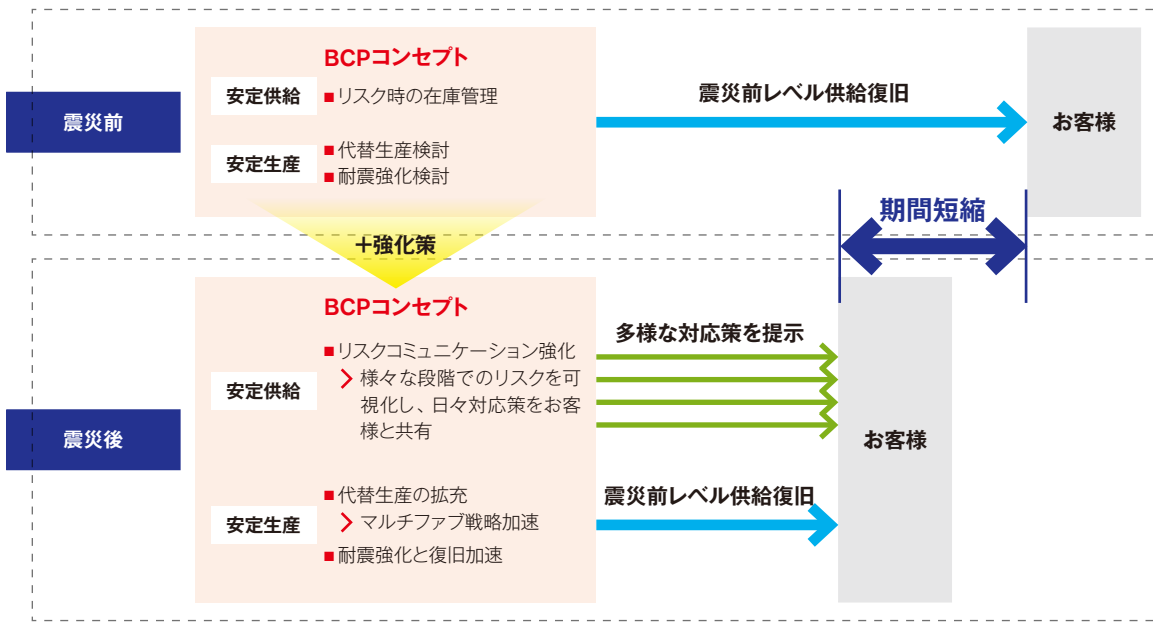
次に、お客様へ継続的に安定供給を行うための最も有効な手段として進めているファブネットワークの構築です。お客様に安心して当社グループの製品を使用していただけるよう、生産体制のマルチファブ化を進め、被災を受けた場合においても代替生産工場からお客様に早期に製品を供給できるようにします。また、マルチファブ化の推進をよりスムーズに実行できるよう、一部の製造プロセスの絞込みも行います。加えて、ファブネットワークの構築は、市況変動への当社グループ自身としての対応力強化にも貢献します。

そして、SCM<sup>(※)</sup>の強化です。お客様の生産ラインを止めないことを目標に、部材調達から仕掛品や完成品の在庫コントロールを行うことにより、より一層のSCM強化を図ります。

また、部材調達のマルチ化や、2次サプライヤーまで見通したリスク情報の管理など原材料の確保を図ります。そして、仕掛品の保有場所や仕掛品保有数量のリスクコントロールを行い、被災工場の復旧段階での製品出荷ができるような体制を構築します。さらに、当社グループ製品の代替工場の有無やマスクの準備状況等のリスク情報をお客様と共有し、そのリスクについての対応策について多様なメニューをお客様にご提案することで、万が一工場が被災したとしても、お客様にはスムーズな製品の提供が行えるようにします。

(※)SCM: Supply Chain Management

### ルネサスのBCP



## コーポレート・ガバナンス

### ＞コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値を継続的に高めていくためには、経営を効率的に遂行するとともに、経営の健全性と透明性を確保することが重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、経営体制の整備および諸施策の実施に取り組んでいます。

当社は、監査役設置会社形態を採用し、監査役により取締役の職務執行を監査するコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。事業の知識と経験を有する社内出身者を含む常勤監査役が、会計監査人、内部監査部門である内部監査室その他の関係部門と連携を図りつつ質の高い情報を効果

的に収集し、独立性の高い社外監査役を含めた監査役会において、その情報を様々な視点から客観的に分析することを通じ、本体制は十分機能しており、当社のコーポレート・ガバナンスに適していると考えています。

当社は、グループ共通の経営指針である「ルネサス エレクトロニクスグループCSR憲章」を制定しています。当社は、CSR憲章に基づき、良き企業市民として社会的責任を果たすことが継続的な企業価値、株主価値の増大につながると考えています。

### ＞コーポレート・ガバナンス体制の概要

#### 現状の体制の概要

当社は、金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告」（2009年6月17日公表）においてコーポレート・ガバナンスのモデルとして提示された類型の一つである「社外取締役の選任と監査役会等との連携」に準じる体制を採用しています。

当社は、積極的に外部の視点を取り入れ、多角的に経営課題に対処するため、多様な経験や専門知識を有する社外役員を選任しており、10名の取締役のうち、3名を社外取締役とするとともに、3名の社外監査役を選任しています。また、当社の業績およびガバナンス向上のために、的確かつ客観的な助言と判断をいただける優れた人材を求め、当社と利害関係のない独立社外取締役を1名、独立社外監査役を2名選任しており、適切なコーポレート・ガバナンスの体制を実現していると考えています。

#### 業務執行

当社は、職務執行を行う取締役として適任者を選任するため、取締役会が候補者の経歴、経験等を総合的に考慮して株主総会に提出する取締役選任議案を慎重に審議し決定しています。

取締役会は、3名の社外取締役を含む10名で構成されており、原則として月に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要な意思決定を機動的かつ迅速に行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っています。当社において社外取締役は、他の取締役の職務執行が妥当なものか否かを監督およびチェックすること、および自己の経歴から培われた知識、経験、見識等を活かして外部の視点から経営上の意思決定に参加することをその機能および役割としています。今後もこれらの機能および役割を担うために必要な実務経験や専門性を有する人材を、社外取締役として選任する方針です。

なお、取締役会付議案件については、事前審議が不要なものを除き、原則として経営会議で事前審議を行うことにより、審議の充実を図っております。さらに、当社では、社長を委員長とする各種委員会を以下のとおり設置し、広範なリスクに対応しています。

#### 内部統制推進委員会

「内部統制推進委員会」を定期的で開催し、会社法および金融商品取引法に規定する当社グループの内部統制に関する課題および方針等について審議、立案および推進しています。

#### CSR推進委員会

当社グループのCSR活動の方針、目標およびその他活動推進に係わる重要事項を審議、決定しています。

#### 情報管理・セキュリティ委員会

当社グループの情報管理・セキュリティに関する重要な方針および施策を審議、決定しています。

また、当社は、事業執行責任の明確化および職務執行に関する意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入するとともに、取締役会で定める執行役員の業務担当事項および「稟議決裁基本規則」により適切な権限委譲を行っています。

#### 監査役および監査役会

監査役は、取締役の職務執行状況につき監査を実施しています。また、監査役会は、3名の社外監査役を含む5名の監査役で構成されており、原則として月に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、監査方針等を決定するとともに、各監査役から監査状況等の報告を受けています。なお、社外監査役3名のうち2名は、弁護士および公認会計士であり、かつ独立性を有しています。また、常勤監査役川村廣樹氏は、日本電気株式会社および同社の関係会社において、常勤監査役西淳一郎氏は、三菱電機株式会社ならびに株式会社ルネサステクノロジおよび同社の関係会社において、それぞれ長年経理業務に従事しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、非常勤監査役清水芳信氏は、公認会計士の資格を有しています。

各監査役は、監査役会の定めた監査方針等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役および使用人からの事業報告および職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務および財産の状況（コンプライアンス体制、内部統制システムを含む。）の調査、子会社の調査等により、取締役の職務執行を監査しています。また、定期的に内部監査部門や会計監査人から監査についての報告を受けるとともに、随時、情報交換を行う等、相互連携を図っています。

## 内部監査部門

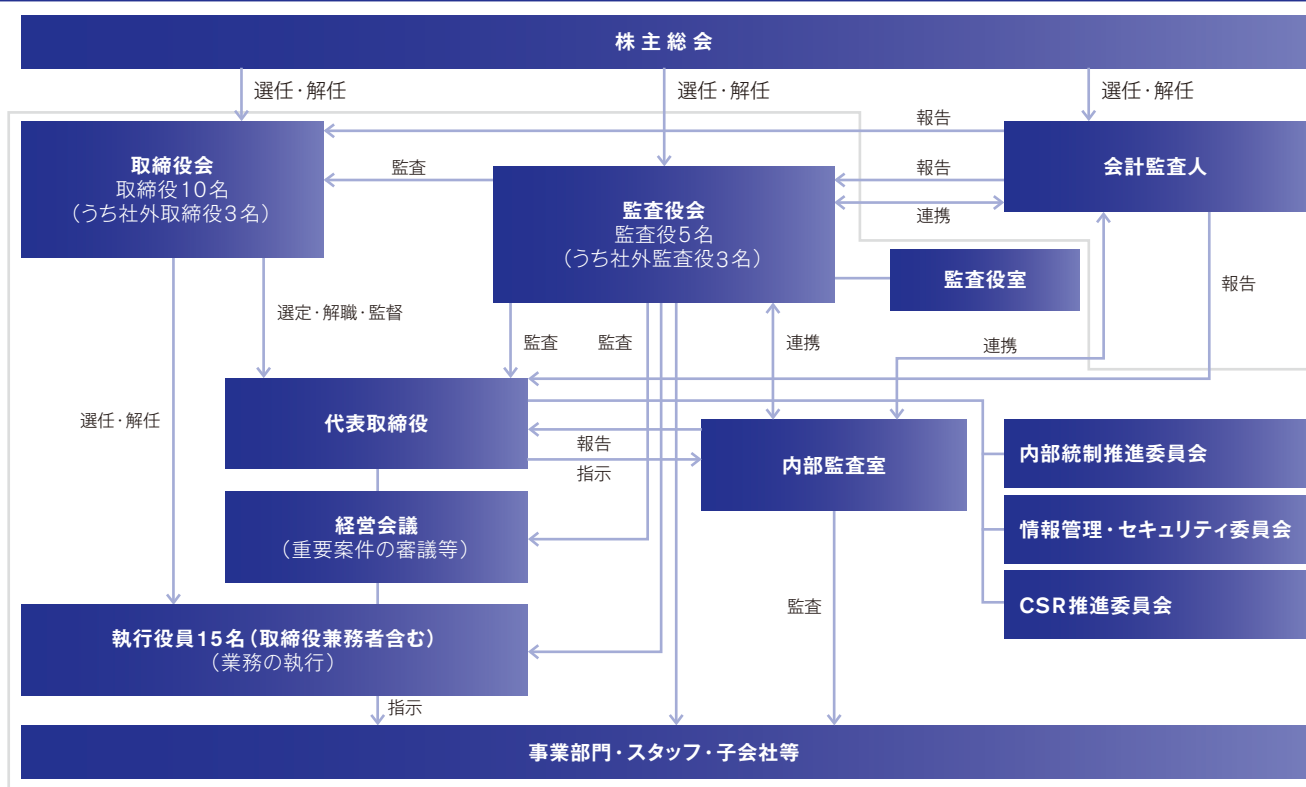
内部監査については、15名からなる内部監査室が、事業執行部門、スタッフ部門、連結子会社等、当社の経営組織の業務執行につき、コンプライアンス、リスク管理および内部統制の観点から、業務執行部門とは独立した第三者的立場から検証・評価し、問題があれば具体的な是正・改善施策を提言しています。

## 会計監査

会計監査については、新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しています。2010年度において当社の会計監査を行った指定有限責任社員および業務執行社員である公認会計士は、松岡寿史、大木一也および内

藤哲哉の3氏であり、継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しています。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士および公認会計士試験合格者等です。

当社および連結子会社が新日本有限責任監査法人に対して支払うべき金銭その他の財産上の利益は総額336百万円であり、そのうち、当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項に規定する業務に対する報酬は243百万円です。また、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、社債発行登録に係る証券会社への書簡作成に関する対価があります。



(2011年6月28日現在)

## 2010年度の役員報酬の内容

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の人数(人)
		基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金	
取締役(社外取締役を除く)	143	143	—	—	—	6
監査役(社外監査役を除く)	22	22	—	—	—	3
社外役員	53	53	—	—	—	10

- 2010年度末現在の取締役は11名(うち社外取締役5名)、監査役5名(うち社外監査役は3名)ですが、上記人員数には、2010年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)、監査役2名(うち社外監査役1名)が含まれています。
- 株主総会決議による取締役の報酬等の限度額は月額30百万円です(2010年2月24日臨時株主総会決議)。
- 株主総会決議による監査役の報酬等の限度額は月額12百万円です(2010年2月24日臨時株主総会決議)。
- 各取締役の報酬については、株主総会で承認された範囲内(月額30百万円以内)において、同業他社の役員報酬や当社従業員の給与水準等を勘案するとともに、当社取締役としての責務に相応する適正な水準を設定のうえ、職位に応じた月額報酬を支給しています。また、各監査役の報酬については、株主総会で承認された範囲内(月額12百万円以内)において、同業他社の監査役報酬、当社取締役の報酬および当社従業員の給与水準等を勘案するとともに、監査役の協議に基づき、当社監査役としての責務に相応する適正な水準を設定のうえ、月額報酬を支給しています。

### ルネサスエレクトロニクスグループCSR憲章

2010年4月1日制定

私たちルネサスエレクトロニクスグループは、高度な技術力に培われた優れた半導体製品と、誠意あるサービスを提供することで、世界中の人々の夢のある未来をつくる企業として、持続可能な社会の実現に寄与します。

そのため、法令を守り、高い倫理観をもって全てのステークホルダーとの共存共栄を図りながら、以下の指針に基づいて誠実に行動します。

#### > お客様のために

お客様のニーズに迅速に応え、最適かつ高品質のソリューションを提供することでお客様満足の最大化を図り、確固たる信頼を獲得してまいります。

#### > 健全な企業活動のために

公平、公正かつ誠実で透明性の高い企業活動を推進し、すべてのステークホルダーの皆様に対し、事業活動内容の積極的な公開に努めます。また、持続的に成長する事業活動を推進することで、企業価値の最大化に努めます。

#### > 働きやすい職場を目指して

従業員等の個性を尊重し、一人ひとりの資質と能力が最大限発揮できる、やりがいのある安全で自由闊達な職場づくりを推進します。

#### > グローバルカンパニーとして

世界の国および地域の歴史、文化、慣習、人権を尊重し、強制労働や児童労働は一切行いません。また、国際社会の一員として世界各地の地域社会に貢献します。

#### > 環境への優しさをもって

環境に配慮した半導体製品の開発・製造・販売を促進すると同時に、開発から廃棄にいたるまで環境負荷の低減を図ります。また、気候変動や生物多様性などの地球全体にかかわる課題に対しても、自らの事業活動を通じて人と環境の調和を図ります。

### > 地球環境保全への取り組み

私たちがお客様に提供する半導体集積回路は、製品そのものの省電力効果や、その製品を採用することによりお客様の製品へ省エネ機能を付加することによって貢献しています。また、その製造過程におきましては、膨大なエネルギー、化学物質を投入し、様々な廃棄物を排出しています。これらを総合的に管理し、お客様、地域社会、株主等あらゆるステークホルダーに貢献できるように、4つの柱(エコマネジメント、エコファクトリー、エコプロダクト、エココミュニケーション)を軸に強力に地球環境保全に取り組んでいます。

### > 環境活動の4本柱

- 法規制遵守や環境管理全般を推進するエコマネジメント活動
  - 温室効果ガス排出抑制、製造時に使用する化学物質の管理により、生産工場の環境への負荷を低減するエコファクトリー活動
  - 製品に含有する化学物質の管理、低消費電力の製品開発など、製品のライフサイクルで環境に配慮した半導体を提供するエコプロダクト活動
  - 環境教育による従業員への意識啓発と、社会に対して当社グループの環境情報を広く公開するエココミュニケーション活動
- これらを環境活動の4本柱として、全事業領域・全員参加による環境活動を推進しています。これらの活動は社長主催のCSR推進委員会によって決定し、環境担当役員主催による環境推進会議によって当社グループに展開されます。



## 2010年度の実績

### エコマネジメント

- 当社グループ間の環境情報共有を図りました。
- 新しい体制での環境推進会議を開催しました。
  - 製造拠点間の環境情報交流を推進しました。
  - 海外を含めて9拠点の環境法遵守監査を実施しました。



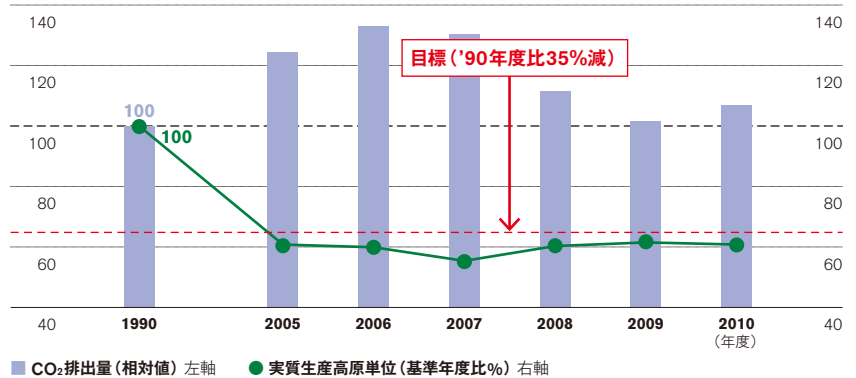
環境推進会議

### エコファクトリー

製造拠点における環境負荷を低減しました。

- 省エネ活動によるエネルギー起源CO<sub>2</sub>排出量の削減、PFCやVOCの使用量の削減による排出量削減を行い、いずれも2010年度の目標を達成しました。
- 廃棄物の削減に努め、2010年度もゼロエミッション(最終処分率1%未満)を達成しました。
- 特定フロンを使用した冷凍機の置き換えを継続実施しました。

### エネルギー起源のCO<sub>2</sub>排出量の推移

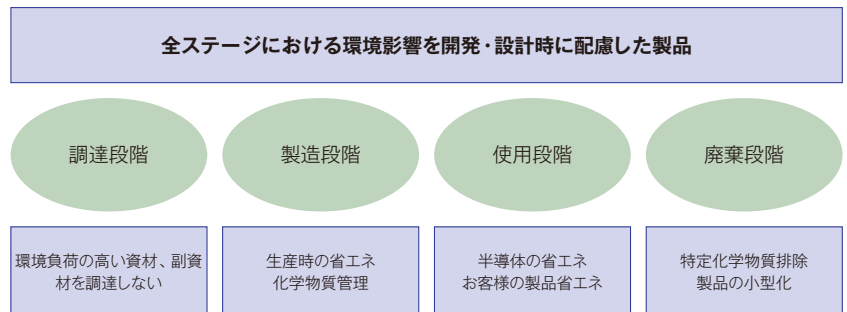


### エコプロダクト

常にお客様に安心して使っていただける製品であるように管理を見直しました。

- 当社グループ統一グリーン調達ガイドラインを制定し、材料・部品の管理を開始しました。
- 設計段階での製品環境アセスメントの適用範囲を順次拡大しています。
- 低消費電力マイコンや高性能マイコンなどのグリーンデバイスをお客様に提供しました。
- 使用化学物質規制の遵守を継続しています。また、化学物質の管理対象を見直し、製造段階で使用される物質、および最終的に製品に含有される物質に分けました。

### エコプロダクト活動 概念図



### エココミュニケーション

ステークホルダーとの共創を推進しました。

- CSR・環境レポートを発行しました。また、Webサイトで、当社グループの環境への取り組みに関する情報を開示しました。
- 製造部門を対象とした教育の充実を図りました。

### 環境教育体系

教育名	目的	内容
一般教育	環境への意識と知識の向上	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 環境ニュース(メールマガジン)</li> <li>• 階層別教育(新入社員、新任主任、新任課長)</li> <li>• 環境基礎教育</li> </ul>
専門教育	職務に必要な環境知識の習得	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設計・開発部門環境教育</li> <li>• 製品環境品質管理教育</li> <li>• 営業部門環境教育</li> <li>• 製造部門環境教育 等</li> </ul>
ISO14001教育	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO14001の仕組みの理解</li> <li>• 内部監査員の養成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO14001基礎教育</li> <li>• 内部監査員教育 等</li> </ul>

## 取締役、監査役および執行役員

(2011年10月1日現在)



**赤尾 泰**  
代表取締役社長



**加藤 正記**  
代表取締役執行役員専務



**小倉 和明**  
取締役執行役員常務



**矢野 陽一**  
取締役執行役員常務



**岩熊 省三**  
取締役執行役員



**水垣 重生**  
取締役執行役員



**古川 享**  
取締役



**橋本 法知**  
取締役



**新野 隆**  
取締役



**山村 雅宏**  
取締役

### 取締役

#### 代表取締役社長

赤尾 泰

#### 代表取締役執行役員専務

加藤 正記

#### 取締役執行役員常務

小倉 和明

矢野 陽一

#### 取締役執行役員

岩熊 省三

水垣 重生

#### 取締役

古川 享(非常勤)

橋本 法知(非常勤)

新野 隆(非常勤)

山村 雅宏(非常勤)

### 監査役

川村 廣樹

西 淳一郎

山川 洋一郎(非常勤)

清水 芳信(非常勤)

中村 豊明(非常勤)

### 執行役員

細見 俊介

宮路 吉朗

鶴丸 哲哉

岩元 伸一

茶木 英明

辻岡 英夫

北野 哲郎

坪井 俊秀

(注) 1. 取締役 古川 享、橋本 法知および新野 隆の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。  
2. 監査役 川村 廣樹、山川 洋一郎および清水 芳信の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

## 財務セクション

連結貸借対照表	24
連結損益計算書	26
連結包括利益計算書	27
連結株主資本等変動計算書	28
連結キャッシュ・フロー計算書	29

当社は、2010年4月1日に、旧NECエレクトロニクス(株)と旧(株)ルネサス テクノロジが合併して誕生しました。各項目における2010年3月期の数値につきましては、旧NECエレクトロニクス(株)の数値です。

## 連結貸借対照表

(単位 百万円)

	2010年3月期 (平成22年3月31日)	2011年3月期 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	24,685	170,691
受取手形及び売掛金	63,752	137,346
有価証券	66,549	166,998
商品及び製品	13,446	45,800
仕掛品	33,411	61,193
原材料及び貯蔵品	10,192	16,378
繰延税金資産	324	1,289
未収入金	8,860	37,966
その他	3,487	4,239
貸倒引当金	△167	△237
流動資産合計	224,539	641,663
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	228,432	294,478
減価償却累計額	△160,424	△174,870
建物及び構築物(純額)	68,008	119,608
機械及び装置	702,430	793,130
減価償却累計額	△617,057	△657,424
機械及び装置(純額)	85,373	135,706
車両運搬具及び工具器具備品	110,068	138,544
減価償却累計額	△93,747	△104,392
車両運搬具及び工具器具備品(純額)	16,321	34,152
土地	14,737	35,887
建設仮勘定	13,538	20,947
有形固定資産合計	197,977	346,300
無形固定資産		
のれん	—	2,485
ソフトウェア	13,214	28,742
その他	705	52,003
無形固定資産合計	13,919	83,230
投資その他の資産		
投資有価証券	194	10,635
繰延税金資産	1,077	2,100
長期前払費用	7,196	43,096
前払年金費用	6,658	—
長期未収入金	5,829	—
その他	2,539	18,024
投資その他の資産合計	23,493	73,855
固定資産合計	235,389	503,385
資産合計	459,928	1,145,048

(単位 百万円)

	2010年3月期 (平成22年3月31日)	2011年3月期 (平成23年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	74,595	144,944
1年内償還予定の新株予約権付社債	—	110,000
短期借入金	2,450	143,467
1年内返済予定の長期借入金	3,104	44,321
リース債務	3,223	8,176
未払金	21,525	78,250
未払費用	22,709	55,538
未払法人税等	2,812	3,962
製品保証引当金	253	590
債務保証損失引当金	—	456
事業構造改善引当金	—	2,239
偶発損失引当金	1,545	399
災害損失引当金	—	46,042
資産除去債務	—	404
その他	7,642	6,474
流動負債合計	139,858	645,262
固定負債		
新株予約権付社債	110,000	—
長期借入金	11,062	58,192
リース債務	11,054	14,073
繰延税金負債	7,097	14,063
退職給付引当金	40,098	84,831
偶発損失引当金	1,228	1,163
資産除去債務	—	5,426
その他	3,193	30,980
固定負債合計	183,732	208,728
負債合計	323,590	853,990
純資産の部		
株主資本		
資本金	85,955	153,255
資本剰余金	242,586	450,413
利益剰余金	△182,611	△297,634
自己株式	△11	△11
株主資本合計	145,919	306,023
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△16	△259
為替換算調整勘定	△13,649	△22,007
その他の包括利益累計額合計	△13,665	△22,266
新株予約権	52	48
少数株主持分	4,032	7,253
純資産合計	136,338	291,058
負債純資産合計	459,928	1,145,048

## 連結損益計算書

(単位 百万円)

	2010年3月期 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	2011年3月期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
売上高	471,034	1,137,898
売上原価	353,781	745,927
売上総利益	117,253	391,971
販売費及び一般管理費	166,488	377,447
営業利益又は営業損失(△)	△49,235	14,524
営業外収益		
受取利息	245	553
受取配当金	—	83
持分法による投資利益	—	759
受取補償金	881	—
助成金収入	711	—
その他	866	2,250
営業外収益合計	2,703	3,645
営業外費用		
支払利息	586	3,777
有価証券評価損	6	—
為替差損	937	5,783
固定資産廃棄損	2,506	2,952
退職給付費用	2,376	2,383
その他	1,454	2,241
営業外費用合計	7,865	17,136
経常利益又は経常損失(△)	△54,397	1,033
特別利益		
固定資産売却益	557	768
負ののれん発生益	—	2,159
偶発損失引当金戻入額	9,576	1,774
子会社株式売却益	98	—
子会社清算益	42	—
事業譲渡益	—	1,192
投資有価証券売却益	—	320
受取補償金	—	116
特別利益合計	10,273	6,329
特別損失		
固定資産売却損	16	402
減損損失	646	36,051
災害による損失	—	49,504
事業構造改善費用	5,600	30,598
訴訟関連損失	2,098	—
投資有価証券売却損	171	—
投資有価証券評価損	161	119
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	1,488
特別損失合計	8,692	118,162
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△52,816	△110,800
法人税、住民税及び事業税	2,245	2,885
法人税等調整額	1,871	△829
法人税等合計	4,116	2,056
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	—	△112,856
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△500	2,167
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,432	△115,023

## 連結包括利益計算書

(単位 百万円)

	2010年3月期 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	2011年3月期 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は 少数株主損益調整前当期純損失(△)	—	△112,856
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	△239
為替換算調整勘定	—	△8,744
持分法適用会社に対する持分相当額	—	△12
その他の包括利益合計	—	△8,995
包括利益	—	△121,851
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	△123,624
少数株主に係る包括利益	—	1,773

# 連結株主資本等変動計算書

(単位 百万円)

	2010年3月期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	2011年3月期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	85,955	85,955
当期変動額		
新株の発行	—	67,300
当期変動額合計	—	67,300
当期末残高	85,955	153,255
資本剰余金		
前期末残高	242,586	242,586
当期変動額		
新株の発行	—	67,300
合併による増加	—	140,527
当期変動額合計	—	207,827
当期末残高	242,586	450,413
利益剰余金		
前期末残高	△126,179	△182,611
当期変動額		
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,432	△115,023
当期変動額合計	△56,432	△115,023
当期末残高	△182,611	△297,634
自己株式		
前期末残高	△11	△11
当期変動額		
自己株式の取得	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0
当期末残高	△11	△11
株主資本合計	202,351	145,919
当期変動額		
新株の発行	—	134,600
合併による増加	—	140,527
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,432	△115,023
自己株式の取得	△0	△0
当期変動額合計	△56,432	160,104
当期末残高	145,919	306,023
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	2	△16
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△18	△243
当期変動額合計	△18	△243
当期末残高	△16	△259
為替換算調整勘定		
前期末残高	△12,183	△13,649
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,466	△8,358
当期変動額合計	△1,466	△8,358
当期末残高	△13,649	△22,007
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	△12,181	△13,665
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,484	△8,601
当期変動額合計	△1,484	△8,601
当期末残高	△13,665	△22,266
新株予約権		
前期末残高	67	52
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△15	△4
当期変動額合計	△15	△4
当期末残高	52	48
少数株主持分		
前期末残高	4,467	4,032
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△435	3,221
当期変動額合計	△435	3,221
当期末残高	4,032	7,253
純資産合計		
前期末残高	194,704	136,338
当期変動額		
新株の発行	—	134,600
合併による増加	—	140,527
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,432	△115,023
自己株式の取得	△0	△0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,934	△5,384
当期変動額合計	△58,366	154,720
当期末残高	136,338	291,058

# 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

	2010年3月期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	2011年3月期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△52,816	△110,800
減価償却費	52,957	103,494
長期前払費用償却額	5,051	11,596
減損損失	646	36,051
災害による損失	—	6,187
負ののれん発生益	—	△2,159
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,318	△8,532
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	—	505
偶発損失引当金の増減額(△は減少)	△9,595	△1,807
災害損失引当金の増加額(△は減少)	—	46,042
受取利息及び受取配当金	△245	△636
支払利息	586	3,777
持分法による投資損益(△は益)	—	△759
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)	338	△201
固定資産売却損益(△は益)	△541	△366
固定資産廃棄損	2,506	2,952
事業構造改善費用	3,767	7,895
事業譲渡損益(△は益)	—	△1,192
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	1,488
子会社株式売却益	△98	—
子会社清算益	△42	—
売上債権の増減額(△は増加)	△18,398	39,807
たな卸資産の増減額(△は増加)	5,578	△880
未収入金の増減額(△は増加)	△1,928	△10,368
仕入債務の増減額(△は減少)	14,171	△35,490
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	1,252	27,886
未払消費税等の増減額(△は減少)	1,952	—
その他	△1,459	1,794
小計	9,000	116,284
利息及び配当金の受取額	276	670
利息の支払額	△586	△3,826
法人税等の支払額	△1,020	△5,450
特別退職金の支払額	△1,410	△786
訴訟等関連損失の支払額	—	△4,407
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,260	102,485
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額(△は増加)	—	531
有形固定資産の取得による支出	△59,547	△77,111
有形固定資産の売却による収入	20,287	7,526
無形固定資産の取得による支出	△2,174	△9,875
長期前払費用の取得による支出	△1,534	△2,007
投資有価証券の取得による支出	—	△465
投資有価証券の売却による収入	1,229	649
子会社株式の取得による支出	—	△649
事業譲渡による収入	—	3,285
事業譲受による支出	—	△17,654
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	158	86
その他	△647	△80
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,228	△95,764
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	1,324	27,377
長期借入れによる収入	15,000	40,056
長期借入金の返済による支出	△834	△53,970
自己株式の取得による支出	△0	—
株式の発行による収入	—	134,600
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,939	△8,256
割賦債務の返済による支出	△2,906	△6,853
セール・アンド・リースバック取引による収入	15,992	—
その他	—	△357
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,637	132,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	△714	△5,155
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△10,045	134,163
現金及び現金同等物の期首残高	101,279	91,234
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	111,892
現金及び現金同等物の期末残高	91,234	337,289

# グローバルネットワーク

(2011年8月現在)

## 国内拠点

### ■ 製造

ルネサス エレクトロニクス  
ルネサス北日本セミコンダクタ  
羽黒電子  
北海電子  
ルネサス山形セミコンダクタ  
ルネサス那珂セミコンダクタ  
ルネサス東日本セミコンダクタ

ルネサス甲府セミコンダクタ  
ルネサス ハイコンポーネンツ  
ルネサス柳井セミコンダクタ  
ルネサス関西セミコンダクタ  
ルネサス セミコンダクタ九州・山口  
ルネサス九州セミコンダクタ

### ■ 設計・応用技術

ルネサス エレクトロニクス  
ルネサス ソリューションズ  
ルネサス マイクロシステム  
ルネサス デザイン

### ■ エンジニアリングサービス

ルネサス セミコンダクタ エンジニアリング  
ルネサス高崎エンジニアリングサービス  
ルネサス武蔵エンジニアリングサービス  
ルネサス北伊丹エンジニアリングサービス



## 海外拠点

### ■ 製造

Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd.  
Renesas Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd.  
Shougang NEC Electronics Co., Ltd.  
Renesas Semiconductor Singapore Pte. Ltd.  
Renesas Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd.  
Renesas Semiconductor Technology (M) Sdn. Bhd.  
Renesas Semiconductor (Kedah) Sdn. Bhd.  
Renesas Semiconductor KL Sdn. Bhd.

■ 製造 ● 設計・応用技術 ● 販売 ● その他

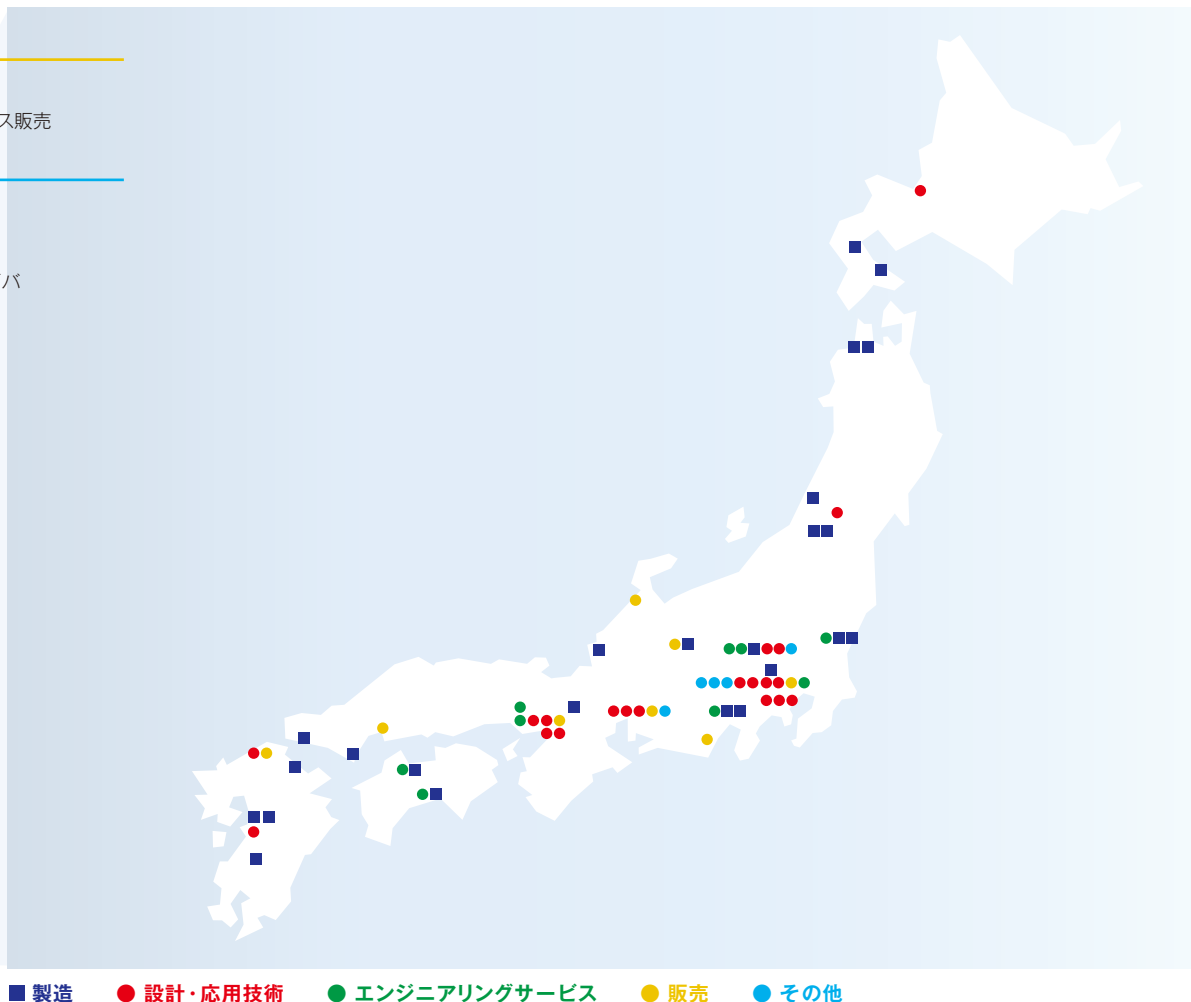
## ■ 販売

ルネサス エレクトロニクス販売

## ■ その他

ルネサス モバイル

ルネサス エスピードライバ



## ■ 設計・応用技術

Renesas Design France S.A.S  
Renesas Design Vietnam Co., Ltd.  
Renesas Semiconductor Design (Beijing) Co., Ltd.  
Renesas Semiconductor Design  
(Malaysia) Sdn. Bhd.  
Renesas System Solutions Korea Co., Ltd.

## ■ 販売

Renesas Electronics America Inc.  
Renesas Electronics Canada Limited  
Renesas Electronics Europe Limited  
Renesas Electronics Europe GmbH  
Renesas Electronics (China) Co., Ltd.  
Renesas Electronics (Shanghai) Co., Ltd.  
Renesas Electronics Hong Kong Limited  
Renesas Electronics Taiwan Co., Ltd.  
Renesas Electronics Singapore Pte. Ltd.  
Renesas Electronics Malaysia Sdn. Bhd.  
Renesas Electronics Korea Co., Ltd.

## ■ その他

Renesas Mobile Europe Oy  
Renesas Mobile (Beijing) Co., Ltd.  
Renesas Mobile India Private Limited  
Renesas SP Drivers Taiwan Inc.

## 株式情報

(2011年3月31日現在)

---

### 発行済株式の総数

417,121,942株(自己株式2,548株を除く)

---

### 大株主(上位10名)

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
(株)日立製作所	127,725	30.62
三菱電機(株)	104,502	25.05
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (住友信託銀行再信託分・日本電気(株)退職給付信託口)	78,200	18.75
日本電気(株)	69,695	16.71
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02	4,022	0.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3,654	0.88
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST, LONDON-CLIENTS ACCOUNT	3,555	0.85
GOLDMAN, SACHS & CO. REG	1,572	0.38
DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-TREATY CLIENTS 613	1,439	0.34
ルネサス エレクトロニクス従業員持株会	1,147	0.28

(注)1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。

2. 持株比率は、自己株式2,548株を除いて算出しています。

3. 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(住友信託銀行再信託分・日本電気(株)退職給付信託口)の持株数78,200,000株(持株比率18.75%)は、日本電気(株)が保有する当社株式の一部を退職給付信託に拠出したものであり、その議決権行使の指図権は同社が留保しています。そのため、日本電気(株)は、当社の議決権の35.46%を保有しています。

---

### 株主名簿管理人

住友信託銀行株式会社

証券代行部:〒104-0028 東京都中央区八重洲2-3-1

郵便物送付先:〒183-8701 東京都府中市日鋼町1-10

住所変更等用紙のご請求 ☎0120-176-417

---

### 上場証券取引所

東京証券取引所市場第一部(証券コード:6723)

---

## 商号

ルネサス エレクトロニクス株式会社

---

## 設立

2002年11月1日

(2010年4月1日 ルネサス エレクトロニクス株式会社として営業開始)

---

## 資本金

1,532億円(2011年3月31日現在)

---

## 主な事業

各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス

---

## 従業員数(連結)

46,630名(2011年3月31日現在)

---

## 本店所在地

神奈川県川崎市中原区下沼部1753

---

## 本社事務所

東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

---

## インベスター・リレーションズ

<http://japan.renesas.com/ir/>

当社は、「ルネサス エレクトロニクスグループCSR憲章」に基づき、公平、公正かつ誠実で透明性の高い企業活動を推進するとともに、その活動内容の積極的な公開に努めております。

---

## お問い合わせ先

ルネサス エレクトロニクス株式会社

コーポレートコミュニケーション部 IR課

Tel: 03-6756-5552

Fax: 03-5201-5109

Email: [ir@renesas.com](mailto:ir@renesas.com)



ルネサス エレクトロニクス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

Tel: 03-5201-5111 (大代表)

<http://japan.renesas.com/>

